



武创芯研科技（武汉）有限公司研发工程师招聘需求

公司简介

武创芯研科技（武汉）有限公司由武汉产业创新发展研究院联合武汉大学工业科学研究所刘胜院士团队，以及湖南珞佳智能科技有限公司共同组建，整合武汉大学、华中科技大学等国内一流科研力量及平台资源。武创院芯研所聚焦国家集成电路制备、封装面临的“卡脖子”问题，针对器件集成、芯片封装工艺及可靠性关键核心技术开展攻关、产学研转化孵化，内辖先进集成、封装材料及工艺综合研发及测试平台、芯片制造-封测材料数据库平台、多场多尺度耦合的芯片制造协同仿真平台、芯片制造-封装 CAPR 工业软件开发平台，为集成电路设计制造全流程中的四个关键性协同做好保驾护航：1）多物理场协同，2）多尺度协同、3）设计与制程工艺协同，4）上下游产业链协同。

武创芯研科技(武汉)有限公司作为武创院的实体运营单位，2024 年先后入库“科技型中小企业”、国家“高新技术企业”，是湖北省第一个集前沿材料产品开发、芯片封装工艺可靠性模型以及本构数据库开发为一体的新型研发机构，主要从事先进封装与集成材料开发、工艺及可靠性建模仿真研究、以及自主工艺及可靠性 CAE 软件开发。

芯研科技坚持以核心技术创新突围和市场化机制运营为导向，由中国科学院院士、武创院芯研所所长刘胜教授 领衔，聚集了多领域专家学者，技术竞争优势明显。芯研科技技术团队深耕半导体领域二十余年，先后获得国家技术发明二等奖、国家科学进步一等奖等系列奖励，为改变我国集成电路制备封装技术受制于人的局面做出了突出贡献。

为加快集成电路产业综合技术创新能力，武创芯研科技将全面打造**集成电路材料产业化平台**，由海外知名集成电路企业专家直接带队，协同业内头部集成电路企业，针对目前集成封装前沿材料技术展开公关及产品化，建立拥有深层次材料设计、研发、产业化于一体的科技企业。

招聘岗位

一、研发工程师（半导体集成、封装材料）

岗位职责：

1. 参与、主导集成电路制备和封装材料产品开发技术调研、实施路线制定；
2. 带领助理研发人员开展日常实验室工作，实验结果总结、汇报、交流；
3. 根据实验进展调整技术线路，实施技术产品化过度；
4. 参与产品客户定期交流、产线测试跟踪。

任职要求：

5. 化学或相关专业**博士**学位，具备有机合成、分析实验经验，或高分子合成实验和表征经验。曾有合成产物放大经验、产品生产品质管理经验的更佳，但非必要条件；
6. 较强的自主开展课题研究、推进项目进展能力；
7. 逻辑思维清晰、专业沟通能力强；
8. 较强的英语文献查阅和写作能力；
9. 具备团队合作、交流能力。

博士薪资：35W+/年，上不封顶，具体面议。

二、研发工程师

岗位职责：

1. 参与集成电路制备和封装材料产品研发；
2. 协助开展产品开发技术调研、实施路线制定；
3. 提交实验结果分析、进展报告；
4. 在项目负责人带领下开展研发实验；
5. 参与产品客户定期交流、产线测试跟踪。

任职要求：

1. 化学或相关专业**硕士**学位，具备有机合成、分析实验经验，或高分子合成实验及表征经验；曾有合成产物放大经验、产品生产品质管理经验的更佳，但非必要条件；

要条件

2. 在项目负责人带领下开展课题调研、实验操作能力；
3. 逻辑思维清晰、具备专业沟通能力；
4. 基本英语文献查阅和写作能力；
5. 具备团队合作精神。

硕士薪资：16W+/年，上不封顶，具体面议。

公司地址：武汉东湖高新区武创院本部大楼 B 座 13 楼

公司网页：<http://www.xhicapr.com/>

联系电话：13669017200（微信同号）

联系人：秦婷

邮 箱：qinting@xhicapr.com

